

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
期末配当金受領株主確定日	3月31日
中間配当金受領株主確定日	9月30日
定時株主総会	毎年6月
単元株式数	100株
株主名簿管理人及び特別口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 TEL. 0120-094-777 (通話料無料)
上場証券取引所	東京証券取引所市場第一部
証券コード	4971
公告の方法	電子公告により行う 公告掲載URL http://www.mec-co.com/ir/denshi/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)

【ご注意】

- 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできません。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記の特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。



メック株式会社

本社事務所 / 〒660-0881
兵庫県尼崎市昭和通三丁目95番地 アマックスビル
TEL. 06-6414-3451(代) FAX. 06-6414-3455

URL <http://www.mec-co.com/>

ニュースメール配信サービスのご案内

当社では、ホームページにニュースリリースや新しいコンテンツが掲載された際に、ご登録者のみなさまにそのタイトルとURLを電子メールにてお知らせするサービス(ニュースメール配信サービス)を行っています。

ご希望の株主さまには、こちらのサービスの送信先メールアドレス(携帯電話のメールアドレス不可)を、当社ホームページまたは、ティア・ネットサービスシステム(<http://www.dirnet.jp/>)から、簡単にご登録いただけます(無料)。

アンケートのお願い

当社では、株主のみなさまとのよりよいコミュニケーションを目指し、今後も業績情報の開示の充実に努めてまいりたいと考えております。

つきましては、この株主通信に対するご意見、ご感想をお聞かせいただきたくアンケートにご協力をお願いいたします。

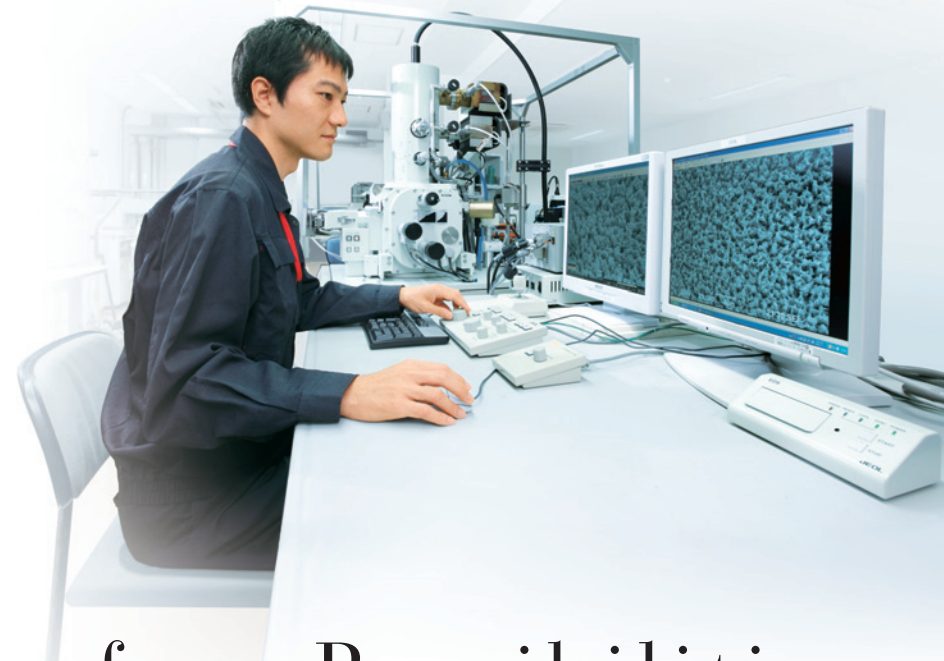
同封のアンケートハガキにご記入のうえ、ご投函ください。

今後とも、ご指導ご鞭撻何卒よろしくお願い申し上げます。



メック株式会社

証券コード：4971



Creating Surface Possibilities

第43期中間 株主通信

平成23年4月1日から平成23年9月30日まで

- P1 TOPICS
- P2 株主・投資家のみなさまへ
- P6 財務ハイライト
- P7 連結財務諸表
- P9 会社概要
- P10 株式の状況
- P11 株主メモ

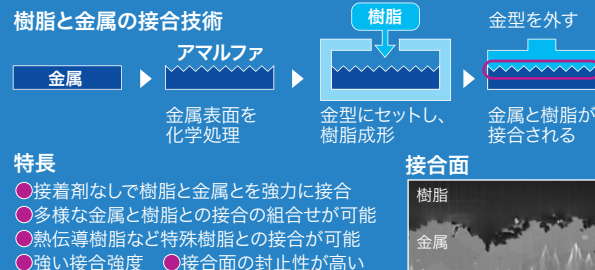


TOPICS

樹脂と金属とを一体成形する新接合技術「AMALPHA／アマルフア」の拡販を推進します。

接着剤なしで樹脂と金属とを強力に接合する独自技術を開発。

当社が開発した新しい金属表面処理技術「AMALPHA／アマルフア」は、金属表面を化学処理して、金属と樹脂を接合する技術。今まで当社が培ってきた金属の表面粗化技術を活用し、銅やアルミなど多様な金属部材が処理できるため、さまざまな樹脂との一体成形を実現します。電子機器製品の軽量化や工数・コスト削減への期待から、多くの金属加工メーカー様や樹脂メーカー様から引き合いをいただいております。



特長

- 接着剤なしで樹脂と金属とを強力に接合
- 多様な金属と樹脂との接合の組合せが可能
- 熱伝導樹脂など特殊樹脂との接合が可能
- 強い接合強度 ●接合面の封止性が高い

自動車部品はもとより自動車本体、多様な電子機器の軽量化に。

自動車の軽量化に



LED照明の高寿命化に



PCの小型・軽量化に

「AMALPHA／アマルフア」の潜在的な用途市場は大きく、まずは自動車のドア部品やバンパー部材、車載電子機器など、軽量化が求められる比較的ハイエンド市場での採用を見込んでいます。またアルミ表面のAMALPHA処理によって、熱伝導性の高い樹脂と接合させることで放熱性能が向上。アルミの容量削減で軽量化や低コスト化にもつながることから当面、発光ダイオード(LED)電球市場での拡販を目指してまいります。

株主・投資家のみなさまへ

グローバル化対応をさらに進め、 独創技術を「世界一」に磨いて新事業の柱へ――

株主、投資家のみなさまには、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

東日本大震災以降、お客様の生産動向、原料・資材調達に若干の懸念はございましたが、日本国内の電子部品業界は再び前進を始めました。しかしながら一方では、米国、ユーロ圏の金融・財政問題等による信用不安、タイの大洪水の影響等不確定要因も顕在化しております。

このような環境のもと、当社におきましては、これまで以上にエレクトロニクス関連業界全体のグローバルな動向と地域ごとの客先需要の把握に努め、現地での対応力を強化するとともに、国内におきましては独創の技術を磨いて、新しい市場開拓に努めてまいります。

次代に向けた具体的な取り組みとしましては、当社が培ってきました、電子基板の「界面処理」技術を電子基板以外の市場に向けて応用展開していきます。例えば、接着剤を使用することなく、金属と樹脂とを一体成形する新技術「AMALPHA／アマルフア」。多様な金属と樹脂との接合を可能にし、電子基板以外の幅広い市場において軽量化、省エネ化、低コスト化を実現するこの新技術を、世界一の素材技術に育て上げ、次なる事業の柱にしていく所存でございます。

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしく御礼申し上げます。

代表取締役社長
前田 和夫

平成24年3月期第2四半期連結累計期間の業績および今後の事業方針についてご報告申し上げます。

Q 当期概況と決算における数値について

A 前年同期比で減収減益となったものの懸命な受注努力の結果、平成23年6月発表の計画値を上回る売上高を達成しました。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国、ユーロ圏の金融・財政問題等により依然不安定な状況が続きました。国内におきましても、東日本大震災の影響や世界的な景気の停滞、急激な円高等により先行きが非常に不透明な状況となっております。

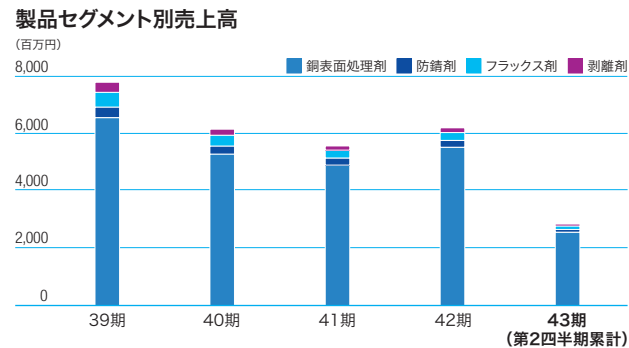
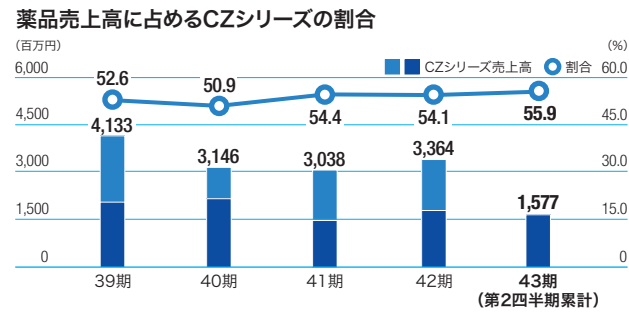
そのような中、エレクトロニクス業界では、スマートフォンやタブレットPC等の販売が堅調に推移したものの、薄型テレビやPCの販売が厳しく、全般に力強い需要はみられませんでした。

電子基板業界では、パッケージ基板を中心とする高密度電子基板を含め、全般に不調となり、エレクトロニクス業界と同様に回復傾向には至りませんでした。

このような状況のもと、当社グループはアジアを中心とする海外

向けの高密度電子基板用薬品の販売と技術サポートに注力する等、懸命な受注努力の結果、平成23年6月29日に発表した平成24年3月期第2四半期(累計)の業績予想を上回る売上高を達成。利益面でも、合理化活動や費用節減活動など地道な努力により、当初予想を上回りました。

その結果、当期間の売上高は32億96百万円(前年同期比7.7%減)となりました。営業利益は4億74百万円(前年同期比11.3%減)、経常利益は4億14百万円(前年同期比11.1%減)、四半期純損失は19百万円の損失(前年同期は、3億40百万円の四半期純利益)となりました。



第2四半期(累計)実績および期末業績予想(連結) (百万円)

	平成23年3月期 第2四半期	平成24年3月期 第2四半期	平成24年3月期 予想
売上高	3,569	3,296	6,650
営業利益	535	474	868
経常利益	466	414	823
当期純利益	340	△ 19	301

※ 業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき当社が合理的に判断したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

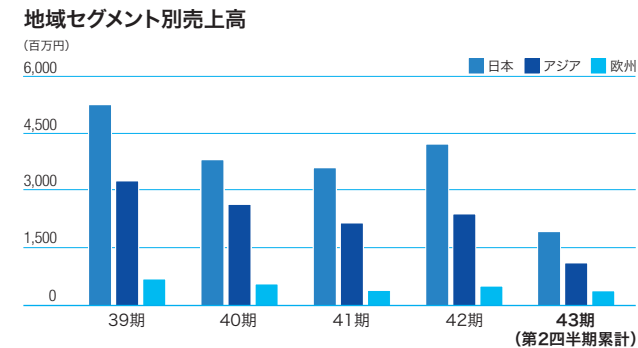
Q 製品セグメント別の販売動向は？

A 薬品はPC販売が不調のなか、超粗化剤CZシリーズのスマートフォン向け用途が増加しました。

当社グループの品目別売上構成比のうち、「薬品」の売上高は28億24百万円(前年同期比9.9%減)となり、売上高全体に占める割合は85.7%(前年同期比2.1%減)となりました。このうち超粗化剤CZシリーズの売上は15億77百万円(前年同期比7.4%減)で、薬品売上高に占める割合は55.9%(前年同期比1.6%増)となりました。

このうちCZシリーズにつきましては、PCに搭載されるMPU用のFCパッケージ向けは減少したものの、世界的な普及により、スマートフォン向け用途での採用が拡大いたしました。

今後は、CZやVボンドなどの銅表面処理剤や配線形成用エッチング剤等、お客様の生産プロセスに付加価値を生む商品を中心に拡販していくことで、当社としても利益の最大化をめざします。



Q 市場動向を踏まえた事業方針は？

A 「もっとグローバルに」を合言葉に意識改革と対応力強化を進め、国内では当社独自の「ニッチトップ」分野拡大に努めます。

エレクトロニクス関連市場では、スマートフォンやタブレットPC以外で、自動車関連がこれから中長期的に期待できる市場と見ています。これらに搭載される電子基板は台湾、韓国、特に中国への移行が進み、最先端の高密度基板の生産体制も拡充されています。当社はこうした需要拡大に対応して東アジア地域で生産、営業拠点を展開してきましたが、今後さらに、グループ一丸となって、技術サポート力の強化やマーケティングを拡充し、市場深耕に努めてまいります。

当期間における当社グループの売上全体に占める海外売上高比率は、東日本大震災の影響等による国内売上の減少もあり49%(前年同期比3%増)^{*}となりました。当社グループとしては「もっとグローバルに」をキーワードに意識改革を進め、国内外の枠組みを取り扱うため営業部門を改組し、お客様一元化対応の体制を整えました。また、国内の電子基板市場に向けては、

研究開発の取り組み

電子基板向け

パッケージ基板等の最先端基板向け薬品の開発	HDI基板の量産用新プロセスの実用化	基板製造時の原価低減、環境負荷低減
-----------------------	--------------------	-------------------

電子基板以外

新技術「AMALPHA/アマルファ」の実用化と応用展開

「界面処理」をコアとした技術・製品開発で当社独自の「ニッチトップ」分野を増やし、国内エレクトロニクス業界の活性化に少しでもお役に立ちたいと考えています。

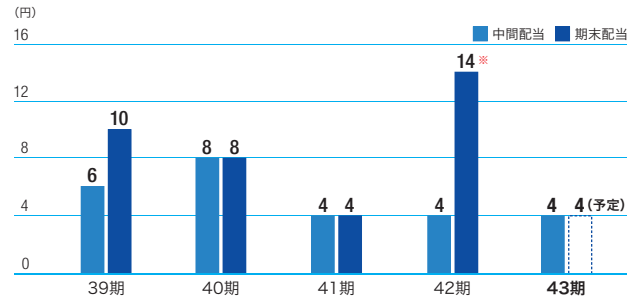
※ 当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は56.7%

Q 研究開発の成果と今後の方針は？

A 量産用新プロセスの実用化と、電子基板以外の新規分野の開拓に注力します。

研究開発につきましては、多層化や高精細化に対応したパッケージ電子基板の表面処理薬品の開発を継続し、とりわけ難度の高い最先端プロセスの製品開発をさらに深化させる一方、近年、需要が拡大しているスマートフォンやタブレットPC等に搭載するHDI(High Density Interconnect)基板の“量産用新プロセス”の実用化に向けた取り組みを通じて、基板の高細線化要求にお応えしてまいります。また、基板処理工程の効率化による原価低減や、多層電子基板製造用プロセスを通じた環境負荷低減に寄与する薬品等、幅広いニーズに応じた製品開発も

1株当たりの配当金



※ 記念配当10円を含む

引き続き推進します。

さらに先を見据えて、これまで培ってきた銅表面処理技術をベースに、その他の金属表面処理への応用展開と、各種用途への適用を目指した研究開発に注力し、電子基板以外の市場へ新技術「AMALPHA/アマalfa」を投入し、次代への新たな価値創造に向けて、布石を打ってまいります。



Q 配当政策については？

A 経済環境が依然厳しいながらも安定配当の考えを維持し、中間配当は1株当たり4円とさせていただきます。

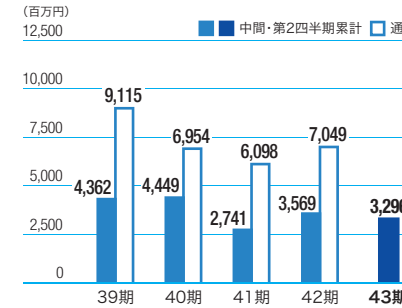
配当金につきましては、依然として当社を取り巻く経済環境が厳しく、不透明なことから、安定配当の考えを維持しつつ、期間利益の反映を図る所存です。当期における配当につきましては、1株当たり中間配当金4円、期末配当金4円の年間8円を予定しております。

今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

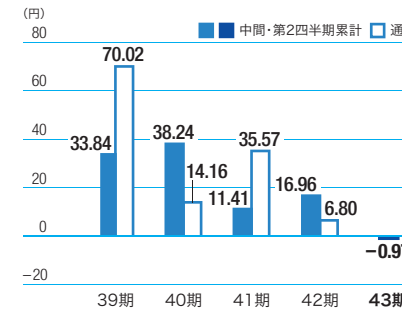
代表取締役社長 前田 和夫

財務ハイライト

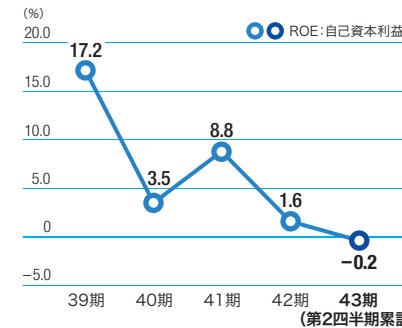
売上高



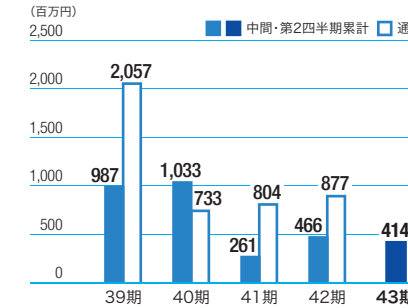
1株当たり当期純利益



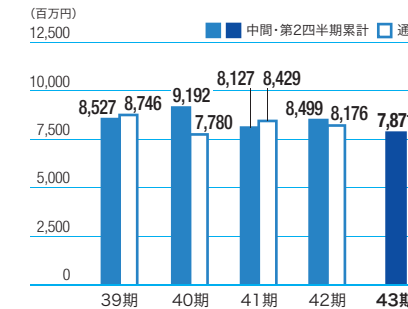
ROE



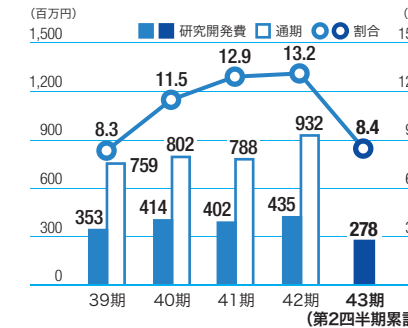
経常利益



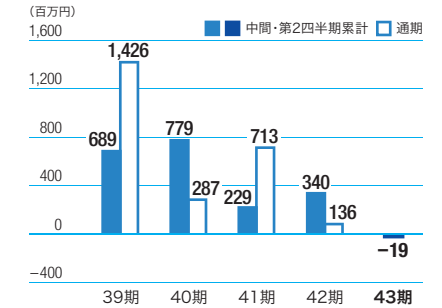
純資産



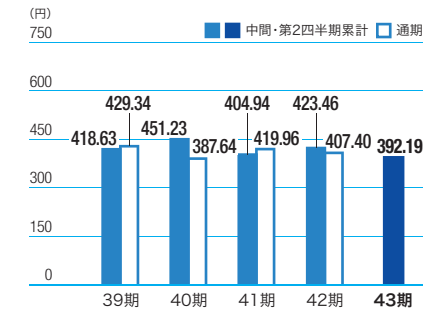
研究開発費の対売上高比率



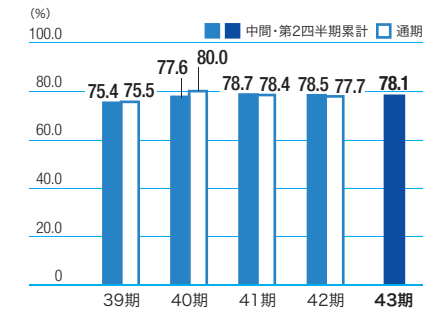
当期純利益



1株当たり純資産



自己資本比率



連結財務諸表

連結貸借対照表(要約)

(単位:千円)

	前連結会計年度末 平成23年3月31日	当第2四半期 連結会計期間末 平成23年9月30日
(資産の部)		
流動資産	5,383,688	5,036,025
1▶ 現金及び預金	2,873,862	2,808,135
2▶ 受取手形及び売掛金	1,907,656	1,667,706
商品及び製品	218,376	174,543
仕掛品	50,034	44,874
原材料及び貯蔵品	194,961	201,334
繰延税金資産	114,406	85,474
その他	43,046	61,011
貸倒引当金	△ 18,656	△ 7,055
固定資産	5,137,724	5,037,862
有形固定資産	4,561,748	4,590,348
建物及び構築物(純額)	1,252,738	1,219,417
機械装置及び運搬具(純額)	317,946	330,275
工具、器具及び備品(純額)	126,185	116,062
土地	2,815,259	2,819,998
3▶ 建設仮勘定	49,618	104,595
無形固定資産	37,433	42,977
投資その他の資産	538,543	404,536
4▶ 投資有価証券	422,246	300,827
その他	120,214	107,983
貸倒引当金	△ 3,918	△ 4,273
資産合計	10,521,412	10,073,887

- Point 1▶ **現金及び預金**:主に日本での配当金および税金の支払いによる減少。
 Point 2▶ **受取手形及び売掛金**:主に日本の売上減少によるもの。
 Point 3▶ **建設仮勘定**:工場拡張工事(珠海)および新製品(薬品)拡販のための貸与機械の製作(台湾)。
 Point 4▶ **投資有価証券**:株式の時価下落による減少。

連結貸借対照表(要約)

(単位:千円)

	前連結会計年度末 平成23年3月31日	当第2四半期 連結会計期間末 平成23年9月30日
(負債の部)		
流動負債	1,770,753	1,649,396
5▶ 支払手形及び買掛金	583,172	483,827
短期借入金	480,000	480,000
未払金	204,098	218,721
未払費用	44,037	39,854
6▶ 未払法人税等	122,070	170,750
賞与引当金	151,000	169,295
その他	186,374	86,948
固定負債	573,749	552,740
繰延税金負債	368,707	328,234
退職給付引当金	99,137	113,642
7▶ その他	105,904	110,863
負債合計	2,344,502	2,202,137
(純資産の部)		
株主資本	8,821,449	8,520,977
資本金	594,142	594,142
資本剰余金	446,358	446,358
8▶ 利益剰余金	7,780,948	7,480,489
自己株式	—	△ 12
その他の包括利益累計額	△ 644,539	△ 649,227
9▶ その他有価証券評価差額金	70,517	15,729
為替換算調整勘定	△ 715,057	△ 664,957
純資産合計	8,176,910	7,871,750
負債純資産合計	10,521,412	10,073,887

- Point 5▶ **支払手形及び買掛金**:主に日本の売上減少に伴う仕入の減少によるもの。
 Point 6▶ **未払法人税等**:主に日本の法人税等の更正通知受領による増加。(法人事業税・住民税以外は支払済み)
 Point 7▶ **その他**:主に設備関係支払手形の減少によるもの。
 Point 8▶ **利益剰余金**:主に配当による減少。
 Point 9▶ **その他有価証券評価差額金**:株式の時価下落による減少。

連結損益計算書(要約)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで	当第2四半期連結累計期間 平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで
10▶ 売上高	3,569,195	3,296,021
売上原価	1,493,648	1,320,394
11▶ 売上総利益	2,075,546	1,975,627
12▶ 販売費及び一般管理費	1,539,860	1,500,668
13▶ 営業利益	535,686	474,958
営業外収益	22,215	21,262
受取利息	6,849	8,052
受取配当金	4,419	5,457
14▶ 株式割当益	5,218	—
その他	5,728	7,752
営業外費用	91,539	81,478
支払利息	2,626	2,237
15▶ 投資有価証券評価損	66,205	35,481
16▶ 為替差損	16,756	40,289
その他	5,950	3,469
17▶ 経常利益	466,363	414,743
特別利益	2,957	4,252
固定資産売却益	1,407	1,507
保険解約返戻金	1,549	2,744
特別損失	7,368	3,963
固定資産売却損	1,965	101
固定資産除却損	2,829	3,862
18▶ 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,572	—
税金等調整前四半期純利益	461,952	415,031
19▶ 法人税等	121,505	190,082
20▶ 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額	—	244,412
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	340,447	△ 19,464
21▶ 四半期純利益又は四半期純損失(△)	340,447	△ 19,464

連結包括利益計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで	当第2四半期連結累計期間 平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	340,447	△ 19,464
その他の包括利益	△ 189,782	△ 4,687
その他有価証券評価差額金	△ 23,447	△ 54,787
為替換算調整勘定	△ 166,334	50,100
四半期包括利益	150,665	△ 24,151
親会社株主に係る四半期包括利益	150,665	△ 24,151
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

- Point 10▶ **売上高**:前年同期に比べ273百万円(7.7%)の減収。薬品売上については2,824百万円となり前年同期より310百万円(9.9%)の減少。機械は27百万円(43.0%)の増加。資材は55百万円(17.8%)の増加。
 Point 11▶ **売上総利益**:前年同期に比べ99百万円(4.8%)の減益。売上総利益率が上昇しているのは、薬品の現地生産化によるコストダウンによるもの。
 Point 12▶ **販売費及び一般管理費**:前年同期に比べ39百万円(2.5%)の減少。人件費および合理化による運賃などの減少が主要因。
 Point 13▶ **営業利益**:前年同期に比べ60百万円(11.3%)の減益。
 Point 14▶ **株式割当益**:前年同期は第一生命保険(相)の株式会社化に伴う株式割当によるもの。
 Point 15▶ **投資有価証券評価損**:前年同期、当期ともに株式時価評価下落による評価損計上。
 Point 16▶ **為替差損**:円高の加速によるもの。
 Point 17▶ **経常利益**:前年同期に比べ51百万円(11.1%)の減益。
 Point 18▶ **資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額**:前年同期は資産除去債務会計基準適用に伴う過年度の費用。
 Point 19▶ **法人税等**:移転価格税制に係る税額計上の際に外国税額控除繰越額の繰延税金資産を取崩したため、法人税等調整額を計上している。
 Point 20▶ **法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額**:移転価格税制に係る更正通知受領によるもの。
 Point 21▶ **四半期純利益又は四半期純損失(△)**:前年同期に比べ359百万円の減益。

会社概要

会社概要 平成23年9月30日現在

商号	メック株式会社
本社事務所所在地	兵庫県尼崎市昭和通三丁目95番地 アマックスビル
設立年月日	1969年(昭和44年)5月1日
資本金	594,142,400円
事業内容	電子基板製造用薬品の製造販売及び 機械装置、各種資材の販売

役員 平成23年9月30日現在

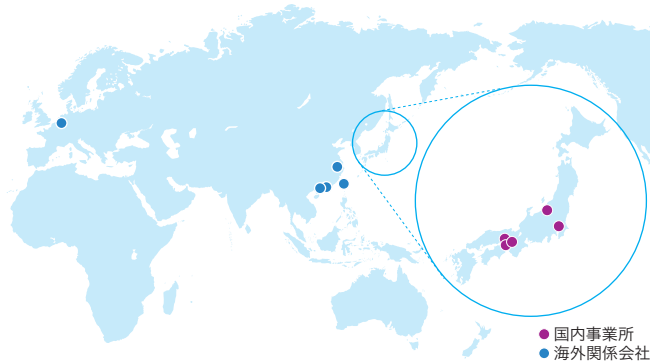
代表取締役社長	前田 和夫
取締役兼専務執行役員	内野 登一
取締役兼常務執行役員	溝口 芳朗
取締役	西川 裕史
監査役(常勤)	藤山 正人
監査役	八田 伸
監査役	松山 英明

国内事業所 平成23年9月30日現在

本社/大阪営業所	〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通三丁目95番地 アマックスビル TEL. 06-6414-3451(代) FAX. 06-6414-3455
東京営業所	〒190-0003 東京都立川市栄町六丁目1番1号 立飛ビル7号館7階 TEL. 042-538-1080(代) FAX. 042-538-1090
新潟営業所/長岡工場	〒940-2045 新潟県長岡市西陵町221番地36 TEL. 0258-47-2490(代) FAX. 0258-47-2492(営業) 0258-47-2493(生産)
西宮工場	〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番19号 TEL. 0798-46-8588(代) FAX. 0798-46-8688
研究所	〒660-0832 兵庫県尼崎市東初島町1番地 TEL. 06-6401-8170(代) FAX. 06-6401-8172

海外拠点 平成23年9月30日現在

MEC TAIWAN COMPANY LTD.	No.3, Ziqiang 6th Rd., Zhongli City, Taoyuan County 320, Taiwan (R.O.C) TEL. 886-3-434-3549 FAX. 886-3-434-5047
MEC EUROPE N.V.	Kaleweg 24-26, B-9030 Gent, Belgium TEL. 32-9-216-7272 FAX. 32-9-216-7270
MEC (HONG KONG) LTD.	No.8, 12/F., Tower 3 China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong TEL. 852-2690-2255 FAX. 852-2690-2262
MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.	530 An Ji East Road, Sanzao Town, Jinwan Qu, Zhuhai City, Guang Dong 519040, China TEL. 86-756-762-2328 FAX. 86-756-762-2628
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) CO., LTD.	31 Linjiang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215121, China TEL. 86-512-6745-1990 FAX. 86-512-6745-1993



株式の状況

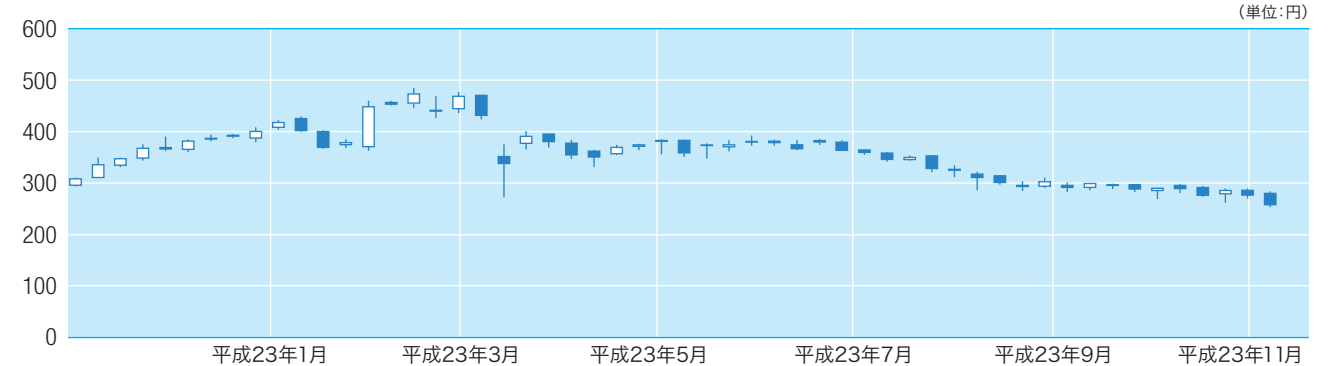
株主状況 平成23年9月30日現在

発行済株式総数	20,071,093株
株主数	4,221名

大株主 平成23年9月30日現在

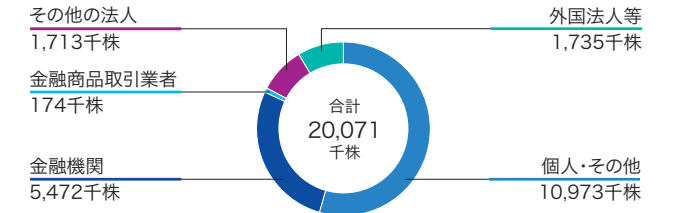
株主名	当社への出資状況	
	所有株数(千株)	持株比率(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,731	13.60
有限会社ケイ・エム・ビジネス	1,130	5.62
前田 耕作	1,005	5.01
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	893	4.45
前田 和夫	681	3.39
野村信託銀行株式会社(投信口)	651	3.24
川邊 豊	602	2.99
小林 義雄	600	2.98
腰高 修	596	2.97
メロンバンクエヌエーティーライアントオムニバス	511	2.54

株価の推移

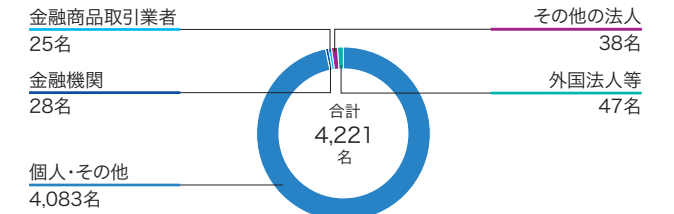


株式分布状況 平成23年9月30日現在

所有株数別株式分布の状況



所有者別の株主数



※「個人・その他」には自己名義株式を含んでおります。